

HSQ-180	Nama Dokumen	Approved	Checked	Prepared
	レーザープログラム管理要領書			

1. 適用範囲 1 HKI社内におけるレーザー加工工程に使用するプログラムの管理に対し適応する。

2. 目的 1 誤製品の作成を防止する為。
2 異材使用による不具合を起こさないことを目的とする。

3. 要領 1

加工指示書（KPK）より、部品品番（プログラム番号）・指示数量、及び材質・板厚が作業者へ指示される。

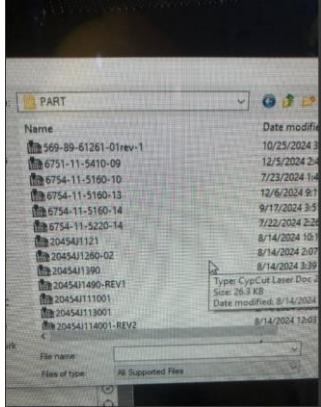


1 of 2 ADDITIONAL KARTU PERINTAH KERJA				Due Date MPP : 07-Jan-25
ADD-20241226	Trolley PC	SOrder	Code	Name
Item Code _56B045211114	1		56B8552112-00-HKW	SHIP
PLATE				Qty.
Process : LASER				Q/Unit
NCT : 0Laser :				
Material : SS400P-4.5X22X679 => 1 Pcs				
Material Size : SS400P-4.5X22X679				RAK DIES :
Proc. Time : Master*Qty [In Minute] SHP : => NCT : => BP : => 0.00				
SHP	NCT	BP	PLASMA	
LASER	PRESS	ROLL		
LOCATION :		Diterima PC :		

SS400P: t4.5x679x22

Print Date : 12/26/2024 7:25:24 PM

レーザーのフォルダから対象のプログラムを選び、切断データを呼び出す。



対応する材料をセットし、切断。

Dibuat	2025, 1 Alasan :	Revisi 3.	Alasan :
Revisi 1.	Alasan :	Revisi 4.	Alasan :
Revisi 2.	Alasan :	Revisi 5.	Alasan :